Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006129

International filing date: 30 March 2005 (30.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-102617

Filing date: 31 March 2004 (31.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 16 June 2005 (16.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 3月31日

出願番号 Application Number: 特願2004-102617

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 悉号

となる出願の国コードと出願 番号 The country code and number of your priority application,

J P 2 0 0 4 - 1 0 2 6 1 7

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

出 願 人 旭化成ケミカルズ株式会社

Applicant(s):

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 5月16日







特許願 【書類名】 X1040370 【整理番号】 特許庁長官 殿 【あて先】 COSL 63/00 【国際特許分類】 【発明者】 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成ケミカルズ株 【住所又は居所】 式会社内 臼井 健敏 【氏名】 【発明者】 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成ケミカルズ株 【住所又は居所】 式会社内 山本 和彦 【氏名】 【特許出願人】 303046314 【識別番号】 旭化成ケミカルズ株式会社 【氏名又は名称】 藤原 健嗣 【代表者】 【代理人】 100108693 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 鳴井 義夫 【選任した代理人】 【識別番号】 100068238 【弁理士】 【氏名又は名称】 清水 猛 【選任した代理人】 100095902 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 伊藤 穣 【選任した代理人】 100103436 【識別番号】 【弁理士】 武井 英夫 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 048596 【予納台帳番号】 【納付金額】 21,000円

特許請求の範囲 1

明細書 1

要約書 1

0314303

【提出物件の目録】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

【包括委任状番号】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

アミンアダクト(A)と低分子アミン化合物(B)を主成分とするアミン系硬化剤であっ て、アミンアダクト(A)の重量平均分子量と数平均分子量の比として定義される分子量 分布が3以下であって、低分子アミン化合物 (B) の含有量がアミンダクト (A) 100 質量部に対して0.001質量部~1質量部であることを特徴とするエポキシ樹脂用アミ ン系硬化剤。

【請求項2】

25℃で固体状であることを特徴とする請求項1記載のエポキシ樹脂用アミン系硬化剤。

【請求項3】

アミンアダクト(A)がエポキシ樹脂(C)とアミン化合物(b1)との反応により得ら れることを特徴とする請求項1又は2記載のエポキシ樹脂用アミン系硬化剤。

【請求項4】

低分子アミン化合物(B)がイミダゾール類であることを特徴とする請求項1~3のいず れか1項に記載のエポキシ樹脂用アミン系硬化剤。

【請求項5】

請求項1~4のいずれか1項に記載のアミン系硬化剤をイソシアネート(D)と活性水素 化合物(E)の反応により得られた皮膜で被覆したエポキシ樹脂用潜在性硬化剤。

【請求項6】

請求項1~5の硬化剤よりなる群より選ばれる少なくとも1種の硬化剤をコアとし、アミ ン系硬化剤とエポキシ樹脂(F)の反応生成物をシェルとしてなるエポキシ樹脂用コアシ ェル型硬化剤。

【請求項7】

請求項1~6の硬化剤よりなる群より選ばれる少なくとも1種の硬化剤100質量部に対 して、 $10\sim50$, 000質量部のエポキシ樹脂(F)を配合してなるエポキシ樹脂用マ スターバッチ型硬化剤。

【請求項8】

エポキシ樹脂 (G) 100質量部に対して、請求項1~7の硬化剤よりなる群より選ばれ る少なくとも1種の硬化剤をアミン系硬化剤の全量が0.1~100質量部となる量を含 有し、それらを主成分とする一液性エポキシ樹脂組成物。

【請求項9】

エポキシ樹脂(G)100質量部に対して、酸無水物類、フェノール類、ヒドラジド類、 およびグアニジン類よりなる群より選ばれる少なくとも 1 種の硬化剤(H)を $1\sim 2$ 0 0 質量部、請求項1~7の硬化剤よりなる群より選ばれる少なくとも1種の硬化剤をアミン 系硬化剤の全量が $0.1\sim100$ 質量部となる量を含有し、それらを主成分とする一液性 エポキシ樹脂組成物。

【請求項10】

請求項8又は9に記載の一液性エポキシ樹脂組成物を含有する異方導電材料。

【請求項11】

請求項8又は9に記載の一液性エポキシ樹脂組成物を含有する導電性接着材料。

【請求項12】

請求項8又は9に記載の一液性エポキシ樹脂組成物を含有する絶縁接着材料。

【請求項13】

請求項8又は9に記載の一液性エポキシ樹脂組成物を含有する封止材。

【書類名】明細書

【発明の名称】硬化剤および組成物

【技術分野】

[0001]

本発明は新規な潜在性硬化剤およびそれを用いた一液性エポキシ樹脂組成物に関する。 さらに詳しくは、硬化性が高いうえに、貯蔵安定性にも優れた組成物を与えるエポキシ樹 脂組成物用潜在性硬化剤およびそれを用いた一液性エポキシ樹脂組成物に関する。

【背景技術】

[0002]

エポキシ樹脂は、その硬化物が、機械的特性、電気的特性、熱的特性、耐薬品性、接着 性等の点で優れた性能を有することから、塗料、電気電子用絶縁材料、接着剤等の幅広い 用途に利用されている。現在一般に使用されているエポキシ樹脂組成物は、使用時にエポ キシ樹脂と硬化剤の二液を混合する、いわゆる二液性のものである。

二液性エポキシ樹脂組成物は室温で硬化しうる反面、エポキシ樹脂と硬化剤を別々に保 管し、必要に応じて両者を計量、混合した後、使用する必要があるため、保管や取り扱い が煩雑である。

そのうえ、可使用時間が限られているため、予め大量に混合しておくことができず、配 合頻度が多くなり、能率の低下を免れない。

[0003]

こうした二液性エポキシ樹脂配合品の問題を解決する目的で、これまでいくつかの一液 性エポキシ樹脂組成物が提案されてきている。例えば、ジシアンジアミド、BF3-アミ ン錯体、アミン塩、変性イミダゾール化合物等の潜在性硬化剤をエポキシ樹脂に配合した ものがある。

しかし、これらの潜在性硬化剤は、貯蔵安定性に優れているものは、硬化温度が高く、 一方、低温で硬化するものは貯蔵安定性が低く、例えば−20℃等の低温で貯蔵する必要 がある。例えば、ジシアンジアミドは、配合品の貯蔵安定性は、常温保存の場合に6ヵ月 以上であるが、170℃以上の硬化温度が必要であり、この硬化温度を低下させるために 、硬化促進剤を併用すると、例えば130℃での硬化が可能であるが、一方、室温での貯 蔵安定性が不十分であり、低温での貯蔵を余儀なくされる。従って、低温硬化性と貯蔵安 定性が共に優れる組成物を与える硬化剤が強く求められている。

[0004]

その要求に対し、アミン系硬化剤のコアを特定のシェルで被覆した所謂マイクロカプセ ル型の硬化剤が提案され、低温硬化性と貯蔵安定性の両立に関して一定の成果を上げてい る。例えば、特許文献1には、特定のアミン系硬化剤をコアとし、上記アミン化合物とエ ポキシ樹脂の反応生成物をシェルとしてなる硬化剤と、エポキシ樹脂とからなる一液性エ ポキシ樹脂組成物用マスターバッチ型硬化剤が開示されている。

しかし近年、特に電子機器分野において、回路の高密度化や接続信頼性の向上に対応す るため、またモバイル機器の軽量化として耐熱性の低い材料を使用するために、あるいは 生産性を大幅に改善する目的で、接続材料の一つとして用いられる一液性エポキシ樹脂組 成物に対して、貯蔵安定性を損なわずに、硬化性の一層の向上が強く求められ、従来技術 ではその達成は困難であった。

[0005]

【特許文献1】特開平01-070523号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

本発明は、速硬化性と貯蔵安定性を両立し得る一液性エポキシ樹脂組成物およびそれを 得るための潜在性硬化剤、そして、貯蔵安定性が高く、低温あるいは短時間の硬化条件で あっても、高い接続信頼性、接着強度、高い封止性が得られる異方導電性材料、導電接着 材料、絶縁接着材料、封止材料等を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、特定分子量分布のアミン アダクトに特定比率の低分子アミン化合物を含有するアミン系硬化剤が上記目的に適合し うることを見出した。この知見に基づいて、本発明をなすに至った。

即ち、本発明は、下記の通りである。

- 1) アミンアダクト (A) と低分子アミン化合物 (B) を主成分とするアミン系硬化剤 であって、アミンアダクト(A)の重量平均分子量と数平均分子量の比として定義される 分子量分布が3以下であって、低分子アミン化合物 (B) の含有量がアミンダクト (B) 100質量部に対して0.001質量部~1質量部であることを特徴とするエポキシ樹脂 用アミン系硬化剤。
- 2) 25℃で固体状であることを特徴とする上記1)記載のエポキシ樹脂用アミン系硬 化剤。
- 3) アミンアダクト (A) がエポキシ樹脂 (C) とアミン化合物 (b 1) との反応によ り得られることを特徴とする上記1)又は2)記載のエポキシ樹脂用アミン系硬化剤。
- 4) 低分子アミン化合物 (B) がイミダゾール類であることを特徴とする上記 1) ~ 3) のいずれかに記載のエポキシ樹脂用アミン系硬化剤。

[0.008]

- 5)上記1)~4)のいずれか1項に記載のアミン系硬化剤をイソシアネート(D)と 活性水素化合物(E)の反応により得られた皮膜で被覆したエポキシ樹脂用潜在性硬化剤
- 6)上記1)~5)の硬化剤よりなる群より選ばれる少なくとも1種の硬化剤をコアと し、アミン系硬化剤とエポキシ樹脂(F)の反応生成物をシェルとしてなるエポキシ樹脂 用コアシェル型硬化剤。
- 7) 上記1) \sim 6) の硬化剤よりなる群より選ばれる少なくとも 1 種の硬化剤 1 0 0 質 量部に対して、10~50、000質量部のエポキシ樹脂(F)からなるエポキシ樹脂用 マスターバッチ型硬化剤。
- 8) エポキシ樹脂 (G) 100質量部に対して、上記1)~~7) の硬化剤よりなる群よ り選ばれる少なくとも1種の硬化剤をアミン系硬化剤の全量が0.1~100質量部とな る量含有し、それらを主成分とする一液性エポキシ樹脂組成物。

[0009]

- 9) エポキシ樹脂(G)100質量部に対して、酸無水物類、フェノール類、ヒドラジ ド類、およびグアニジン類よりなる群より選ばれる少なくとも1種の硬化剤(H)を1~ 200質量部、上記1)~7)の硬化剤よりなる群より選ばれる少なくとも1種の硬化剤 をアミン系硬化剤の全量が0.1~100質量部となる量含有し、それらを主成分とする 一液性エポキシ樹脂組成物。
 - 10)上記8)又は9)に記載の一液性エポキシ樹脂組成物を含有する異方導電材料。
 - 11)上記8)又は9)に記載の一液性エポキシ樹脂組成物を含有する導電性接着材料
 - 12)上記8)又は9)に記載の一液性エポキシ樹脂組成物を含有する絶縁接着材料。
 - 13)上記8)又は9)に記載の一液性エポキシ樹脂組成物を含有する封止材。

【発明の効果】

[0010]

本発明の硬化剤は、高い硬化性と貯蔵安定性の両立に効果を有する。

【発明を実施するための最良の形態】

$[0\ 0\ 1\ 1]$

本発明について、以下具体的に説明する。

本発明のアミン系硬化剤は、アミンアダクト(A)と低分子アミン化合物(B)を主成 分とし、特定比率で含有する.

アミンアダクト(A)は、カルボン酸化合物、スルホン酸化合物、イソシアネート化合

出証特2005-3042289

物、尿素化合物およびエポキシ樹脂(C)からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合 物とアミン化合物(b1)とを反応して得られるアミノ基を有する化合物である。

アミンアダクト(A)の原料として用いられる、カルボン酸化合物、スルホン酸化合物 、イソシアネート化合物、尿素化合物およびエポキシ樹脂(C)を下記に示す。

カルボン酸化合物としては、例えば、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸、フタル酸、 ダイマー酸等が挙げられる。

スルホン酸化合物としては、例えば、エタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸等が 挙げられる。

[0012]

イソシアネート化合物としては、例えば、脂肪族ジイソシアネート、脂環式ジイソシア ネート、芳香族ジイソシアネート、脂肪族トリイソシアネート、ポリイソシアネートを挙 げることができる。脂肪族ジイソシアネートの例としては、エチレンジイソシアネート、 プロピレンジイソシアネート、ブチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネ ート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等を挙げることができる。脂環式ジイ ソシアネートの例としては、イソホロンジイソシアネート、4-4, ージシクロヘキシル メタンジイソシアネート、ノルボルナンジイソシアネート、1,4-イソシアナトシクロ ヘキサン、1,3-ビス(イソシアナトメチル)-シクロヘキサン、1,3-ビス(2-イソシアナトプロピルー2イル)-シクロヘキサン等を挙げることができる。芳香族ジイ ソシアネートの例としては、トリレンジイソシアネート、4, 4'ージフェニルメタンジ イソシアネート、キシレンジイソシアネート、1,5ーナフタレンジイソシアネート等を 挙げることができる。脂肪族トリイソシアネートの例としては、1,3,6ートリイソシ アネートメチルヘキサン、2,6-ジイソシアナトヘキサン酸-2-イソシアナトエチル 等を挙げることができる。ポリイソシアネートとしては、ポリメチレンポリフェニルポリ イソシアネートや上記ジイソシアネート化合物より誘導されるポリイソシアネートが例示 される。上記ジイソシアネートより誘導されるポリイソシアネートとしては、イソシアヌ レート型ポリイソシアネート、ビュレット型ポリイソシアネート、ウレタン型ポリイソシ アネート、アロハネート型ポリイソシアネート、カルボジイミド型ポリイソシアネート等 がある。

尿素化合物としては、例えば、尿素、メチル尿素、ジメチル尿素、エチル尿素、t ーブ チル尿素等が挙げられる。

[0013]

エポキシ樹脂(C)としては、モノエポキシ化合物、多価エポキシ化合物のいずれか又 はそれらの混合物が用いられる。モノエポキシ化合物としては、ブチルグリシジルエーテ ル、ヘキシルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエー テル、パラーtertーブチルフェニルグリシジルエーテル、エチレンオキシド、プロピ レンオキシド、パラキシリルグリシジルエーテル、グリシジルアセテート、グリシジルブ チレート、グリシジルヘキソエート、グリシジルベンゾエート等を挙げることができる。 多価エポキシ化合物としては、例えば、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフ

ェノールAD、ビスフェノールS、テトラメチルビスフェノールA、テトラメチルビスフ エノールF、テトラメチルビスフェノールAD、テトラメチルビスフェノールS、テトラ ブロモビスフェノールA、テトラクロロビスフェノールA、テトラフルオロビスフェノー ルA等のビスフェノール類をグリシジル化したビスフェノール型エポキシ樹脂;ビフェノ ール、ジヒドロキシナフタレン、9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレン等 のその他の2価フェノール類をグリシジル化したエポキシ樹脂;1,1,1-トリス(4 -ヒドロキシフェニル) メタン、4 , 4 - (1 - (4 - (4 -ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル)フェニル)エチリデン)ビスフェノール等のトリスフェノール類 をグリシジル化したエポキシ樹脂;1,1,2,2,一テトラキス(4ーヒドロキシフェ ニル)エタン等のテトラキスフェノール類をグリシジル化したエポキシ樹脂;フェノール ノボラック、クレゾールノボラック、ビスフェノールAノボラック、臭素化フェノールノ ボラック、臭素化ビスフェノールAノボラック等のノボラック類をグリシジル化したノボ ラック型エポキシ樹脂等;多価フェノール類をグリシジル化したエポキシ樹脂、グリセリ ンやポリエチレングリコール等の多価アルコールをグリシジル化した脂肪族エーテル型エ ポキシ樹脂;pーオキシ安息香酸、βーオキシナフトエ酸等のヒドロキシカルボン酸をグ リシジル化したエーテルエステル型エポキシ樹脂;フタル酸、テレフタル酸のようなポリ カルボン酸をグリシジル化したエステル型エポキシ樹脂;4,4-ジアミノジフェニルメ タンやm-アミノフェノール等のアミン化合物のグリシジル化物やトリグリシジルイソシ アヌレート等のアミン型エポキシ樹脂等のグリシジル型エポキシ樹脂と、3,4-エポキ シシクロヘキシルメチルー3', 4'ーエポキシシクロヘキサンカルボキシレート等の脂 環族エポキサイド等が例示される。

[0014]

アミンアダクト(A)の原料として用いられる、カルボン酸化合物、スルホン酸化合物 、イソシアネート化合物、尿素化合物およびエポキシ樹脂(C)のうち、エポキシ樹脂(C) が高い硬化性と貯蔵安定性に優れており好ましい。

エポキシ樹脂(C)としては、エポキシ樹脂組成物の貯蔵安定性を高めることができる ので、多価エポキシ化合物が好ましい。多価エポキシ化合物としては、アミンアダクトの 生産性が圧倒的に高いので、グリシジル型エポキシ樹脂が好ましく、より好ましくは、硬 化物の接着性や耐熱性が優れるため多価フェノール類をグリシジル化したエポキシ樹脂で あり、更に好ましくはビスフェノール型エポキシ樹脂である。ビスフェノールAをグリシ ジル化したエポキシ樹脂とビスフェノールFをグリシジル化したエポキシ樹脂が一層好ま しい。ビスフェノールAをグリシジル化したエポキシ樹脂が更に一層好ましい。

[0015]

エポキシ樹脂(C)の全塩素量は、硬化性と貯蔵安定性のバランスの取れた一液性エポ キシ樹脂組成物を得るためには、1500ppm以下が好ましい。

より好ましくは1000ppm以下であり、より好ましくは800ppm以下であり、 より好ましくは400ppm以下であり、より好ましくは180ppm以下であり、より 好ましくは171ppm以下であり、より好ましくは100ppm以下であり、より好ま しくは80ppm以下であり、さらに好ましくは50ppm以下である。

アミン化合物 (b1) は、少なくとも1 個の一級アミノ基および/または二級アミノ基 を有するが三級アミノ基を有さない化合物と、少なくとも1個の三級アミノ基と少なくと も1個の活性水素基を有する化合物が挙げられる。

[0016]

少なくとも1個の一級アミノ基および/または二級アミノ基を有するが三級アミノ基を 有さない化合物としては、例えば、メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチ ルアミン、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ジエチレ ントリアミン、トリエチレンテトラミン、エタノールアミン、プロパノールアミン、シク ロヘキシルアミン、イソホロンジアミン、アニリン、トルイジン、ジアミノジフェニルメ タン、ジアミノジフェニルスルホン等の三級アミノ基を有さない第一アミン類、例えば、 ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジブチルアミン、ジペンチルアミ ン、ジヘキシルアミン、ジメタノールアミン、ジエタノールアミン、ジプロパノールアミ ン、ジシクロヘキシルアミン、ピペリジン、ピペリドン、ジフェニルアミン、フェニルメ チルアミン、フェニルエチルアミン等の三級アミノ基を有さない第二アミン類を挙げるこ とができる。

少なくとも1個の三級アミノ基と少なくとも1個の活性水素基を有する化合物において 、活性水素基としては一級アミノ基、二級アミノ基、水酸基、チオール基、カルボン酸、 ヒドラジド基が例示される。

[0017]

少なくとも1個の三級アミノ基と少なくとも1個の活性水素基を有する化合物としては 、例えば、2-ジメチルアミノエタノール、1-メチル-2-ジメチルアミノエタノール 、1-フェノキシメチル-2-ジメチルアミノエタノール、2-ジエチルアミノエタノー ル、1ーブトキシメチルー2ージメチルアミノエタノール、メチルジエタノールアミン、

トリエタノールアミン、 $N-\beta-$ ヒドロキシエチルモルホリン等のアミノアルコール類; 2-(ジメチルアミノメチル)フェノール、2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル) フェノール等のアミノフェノール類;2-メチルイミダゾール、2-エチル-4-メチ ルイミダゾール、2ーウンデシルイミダゾール、2ーヘプタデシルイミダゾール、2ーフ エニルイミダゾール、1ーアミノエチルー2ーメチルイミダゾール、1ー(2ーヒドロキ シー3-フェノキシプロピル)-2-メチルイミダゾール、1-(2-ヒドロキシー3-フェノキシプロピル) -2-エチルー4-メチルイミダゾール、1-(2-ヒドロキシー 3-ブトキシプロピル)-2-メチルイミダゾール、1-(2-ヒドロキシ-3-ブトキ シプロピル)-2-エチル-4-メチルイミダゾール等のイミダゾール類;1-(2-ヒ ドロキシー3-フェノキシプロピル)-2-フェニルイミダゾリン、1-(2-ヒドロキ シー3ーブトキシプロピル)ー2ーメチルイミダゾリン、2ーメチルイミダゾリン、2, 4-ジメチルイミダゾリン、2-エチルイミダゾリン、2-エチル-4-メチルイミダゾ リン、2-ベンジルイミダゾリン、2-フェニルイミダゾリン、2-(o-トリル)-イ ミダゾリン、テトラメチレンービスーイミダゾリン、1,1,3ートリメチルー1,4-テトラメチレンービスーイミダゾリン、1,3,3-トリメチルー1,4-テトラメチレ ンービスーイミダゾリン、1, 1, 3-トリメチルー1, 4-テトラメチレンービスー4 ーメチルイミダゾリン、1,3,3ートリメチルー1,4ーテトラメチレンービスー4ー メチルイミダゾリン、1,2ーフェニレンービスーイミダゾリン、1,3ーフェニレンー ビスーイミダゾリン、1, 4-フェニレンービスーイミダゾリン、1, 4-フェニレンー ビスー4ーメチルイミダゾリン等のイミダゾリン類、ジメチルアミノプロピルアミン、ジ エチルアミノプロピルアミン、ジプロピルアミノプロピルアミン、ジブチルアミノプロピ ルアミン、ジメチルアミノエチルアミン、ジエチルアミノエチルアミン、ジプロピルアミ ノエチルアミン、ジブチルアミノエチルアミン、N-メチルピペラジン、N-アミノエチ ルピペラジン、ジエチルアミノエチルピペラジン等の三級アミノアミン類;2-ジメチル アミノエタンチオール、2-メルカプトベンゾイミダゾール、2-メルカプトベンゾチア ゾール、2-メルカプトピリジン、4-メルカプトピリジン等のアミノメルカプタン類; N, N-ジメチルアミノ安息香酸、N, N-ジメチルグリシン、ニコチン酸、イソニコチ ン酸、ピコリン酸等のアミノカルボン酸類;N, Nージメチルグリシンヒドラジド、ニコ チン酸ヒドラジド、イソニコチン酸ヒドラジド等のアミノヒドラジド類を挙げることがで きる。

[0018]

アミン化合物 (b 1) としては、貯蔵安定性と硬化性のバランスが優れているので、少なくとも 1 個の三級アミノ基と少なくとも 1 個の活性水素基を有する化合物が好ましく、イミダゾール類が更に好ましく、2 - メチルイミダゾール、2 - エチルー4 - メチルイミダゾールが一層好ましい。

本発明においては、アミンアダクト(A)の分子量分布を特定範囲にすることで一液性エポキシ樹脂組成物の硬化性を劇的に向上させることができることを見出した。

即ち、本発明に用いられるアミンアダクト(A)の分子量分布は3以下である。ここで分子量分布は重量平均分子量と数平均分子量の比として定義され、ゲルパーミッションクロマトグラフィー(以下GPCと称す)法を用いてポリスチレン換算で求めた分子量より計算される。アミンアダクト(A)の分子量分布は1.01以上2.5以下が好ましく、1.03以上2.0以下が更に好ましく、1.05以上1.5以下が更に一層好ましい。3以下の分子量分布のアミンアダクト(A)を用いることで、硬化性の高い一液性エポキシ樹脂組成物が得られる。

[0019]

本発明に用いられるアミンアダクト(A)は、例えばエポキシ樹脂(C)とアミン化合物(b 1)を、エポキシ樹脂(C)のエポキシ基1当量に対して、アミン化合物(b 1)中の活性水素基が好ましくは 0.8当量~5当量(更に好ましくは 0.9当量~4当量、一層好ましくは 0.95当量~3当量)の範囲で、必要に応じて溶剤の存在下において、例えば 50~250℃の温度で 0.1~10時間反応させることで得られる。エポキシ基

に対する活性水素基の当量比が 0.8以上にすることで分子量分布が 3以下のアミンアダ クト (A) を得るのに有利であり、当量比が5以下で、本発明のアミン系硬化剤に含まれ るアミン化合物(b 1)の含量を所望の値にするために行う、未反応のアミン化合物(b 1) の回収が経済的にでき、有利である。

[0020]

アミンアダクト(A)の製造において、必要に応じて用いられる溶剤としては、特別に 制限するものではないが、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、シクロヘキサン、ミ ネラルスピリット、ナフサ等の炭化水素類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソ ブチルケトン等のケトン類、酢酸エチル、酢酸-n-ブチル、プロピレングリコールモノ メチルエーテルアセテート等のエステル類、メタノール、イソプロパノール、nーブタノ ール、ブチルセロソルブ、ブチルカルビトール等のアルコール類、水、等であり、これら の溶剤は併用しても構わない。用いられた溶剤は蒸留等により除去されることが好ましい

[0021]

本発明に用いられる低分子アミン化合物(B)は、一級、二級および/または三級アミ ノ基を有する化合物が挙げられる。これらは併用することができる。

一級アミノ基を有する化合物としては、例えば、メチルアミン、エチルアミン、プロピ ルアミン、ブチルアミン、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ヘキサメチレンジア ミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、エタノールアミン、プロパノー ルアミン、シクロヘキシルアミン、イソホロンジアミン、アニリン、トルイジン、ジアミ ノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン等を挙げることができる。

二級アミノ基を有する化合物としては、例えば、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジ プロピルアミン、ジブチルアミン、ジペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジメタノール アミン、ジエタノールアミン、ジプロパノールアミン、ジシクロヘキシルアミン、ピペリ ジン、ピペリドン、ジフェニルアミン、フェニルメチルアミン、フェニルエチルアミン等 を挙げることができる。

[0022]

三級アミノ基を有する化合物としては、例えば、トリメチルアミン、トリエチルアミン 、ベンジルジメチルアミン、 N , N ' -ジメチルピペラジン、トリエチレンジアミン、1、8-ジアザビシクロ(5,4,0)-ウンデセン-7、1、5-ジアザビシクロ(4, 3,0)ーノネン-5等の三級アミン類;2ージメチルアミノエタノール、1ーメチルー 2-ジメチルアミノエタノール、1-フェノキシメチル-2-ジメチルアミノエタノール 、2-ジエチルアミノエタノール、1-ブトキシメチルー2-ジメチルアミノエタノール 、メチルジエタノールアミン、トリエタノールアミン、 $\mathrm{N}-eta$ ーヒドロキシエチルモルホ リン等のアミノアルコール類;2-(ジメチルアミノメチル)フェノール、2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール等のアミノフェノール類;2-メチルイミダ ゾール、2-エチル-4-メチルイミダゾール、2-ウンデシルイミダゾール、2-ヘプ タデシルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、1-アミノエチル-2-メチルイミ ダゾール、1-(2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル)-2-メチルイミダゾール 、1-(2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル)-2-エチル-4-メチルイミダゾ ール、1-(2-ヒドロキシ-3-ブトキシプロピル)-2-メチルイミダゾール、1-(2-ヒドロキシ-3-ブトキシプロピル) -2-エチル-4-メチルイミダゾール等の イミダゾール類;1-(2-ヒドロキシー3-フェノキシプロピル)-2-フェニルイミ ダゾリン、1-(2-ヒドロキシ-3-ブトキシプロピル)-2-メチルイミダゾリン、 2-メチルイミダゾリン、2, 4-ジメチルイミダゾリン、2-エチルイミダゾリン、2 ーエチルー4-メチルイミダゾリン、2-ベンジルイミダゾリン、2-フェニルイミダゾ リン、2- (o-トリル) -イミダゾリン、テトラメチレン-ビス-イミダゾリン、1, 1, 3-トリメチルー1, 4-テトラメチレンービスーイミダゾリン、1, 3, 3-トリ メチルー1, 4-テトラメチレン-ビスーイミダゾリン、1, 1, 3-トリメチルー1, 4--テトラメチレンービス-4-メチルイミダゾリン、1,3,3-トリメチル-1,4

―テトラメチレンービスー4ーメチルイミダゾリン、1,2ーフェニレンービスーイミダ ゾリン、1,3-フェニレンービスーイミダゾリン、1,4-フェニレンービスーイミダ ゾリン、1,4-フェニレンービス-4-メチルイミダゾリン等のイミダゾリン類、ジメ チルアミノプロピルアミン、ジエチルアミノプロピルアミン、ジプロピルアミノプロピル アミン、ジブチルアミノプロピルアミン、ジメチルアミノエチルアミン、ジエチルアミノ エチルアミン、ジプロピルアミノエチルアミン、ジブチルアミノエチルアミン、 $\mathbb{N}-$ メチ ルピペラジン、N-アミノエチルピペラジン、ジエチルアミノエチルピペラジン等の三級 アミノアミン類;2-ジメチルアミノエタンチオール、2-メルカプトベンゾイミダゾー ル、2ーメルカプトベンゾチアゾール、2ーメルカプトピリジン、4ーメルカプトピリジ ン等のアミノメルカプタン類;N, Nージメチルアミノ安息香酸、N, Nージメチルグリ シン、ニコチン酸、イソニコチン酸、ピコリン酸等のアミノカルボン酸類;N, Nージメ チルグリシンヒドラジド、ニコチン酸ヒドラジド、イソニコチン酸ヒドラジド等のアミノ ヒドラジド類を挙げることができる。

[0023]

低分子アミン化合物(B)としては、貯蔵安定性の優れた一液性エポキシ樹脂組成物が 得られるため、三級アミノ基を有する化合物が好ましく、イミダゾール類が更に好ましく 、2-メチルイミダゾール、2-エチル-4-メチルイミダゾールが一層好ましい。

本発明では、アミンアダクト(A)に特定量の低分子アミン化合物を含有させることで 貯蔵安定性の高い一液性エポキシ樹脂組成物が得られることを見出した。

即ち、本発明において、アミンアダクト(A)100質量部に対する低分子アミン化合 物 (B) の量は、貯蔵安定性の高い一液性エポキシ樹脂組成物を得るために、0.001 質量部以上1質量部以下の範囲である。好ましくは、0.01質量部以上0.8質量部以 下、一層好ましくは、0.02質量部以上0.6質量部以下、更に一層好ましくは0.0 3質量部以上0.4質量部以下である。

低分子アミン化合物 (B) は、アミンアダクト(A) の製造後にアミンアダクト (A) に混合しても構わないし、アミンアダクト(A)の製造前および/または製造中に混合し ても構わない。また、アミンアダクト(A)の原料であるアミン化合物(b1)の未反応 物を低分子アミン化合物(B)として用いても構わない。

[0024]

本発明のアミン系硬化剤の全塩素量は1500ppm以下が好ましい。より好ましくは 1000ppm以下であり、より好ましくは800ppm以下であり、より好ましくは4 00ppm以下であり、より好ましくは180ppm以下であり、より好ましくは171 ppm以下であり、より好ましくは100ppm以下であり、より好ましくは80ppm 以下であり、さらに好ましくは50ppm以下である。全塩素量が1500ppm以下で 硬化性と貯蔵安定性のバランスの高い一液性エポキシ樹脂組成物を得ることができる。

アミン系硬化剤の形態としては、25℃で固体状であること、即ち、軟化点が25℃を 超えることが好ましい。より好ましくは、軟化点が40℃以上、一層好ましくは軟化点が 60℃以上、より一層好ましくは70℃以上である。25℃で固体状であるアミン系硬化 剤を用いることで、貯蔵安定性の高い一液性エポキシ樹脂組成物が得られる。

固体状のアミン系硬化剤としては、更に、塊状、顆粒状、粉末状、などが挙げられるが 、好ましくは顆粒状または粉末状であり、さらに好ましくは粉末状である。本発明におい て粉末状とは、特別に制限するものではないが、0.1~50μmの平均粒径が好ましく 、さらに好ましくは0.5~10 μ mの平均粒径である。50 μ m以下にすることで、均 質な硬化物を得ることができる。本発明でいう粒径とは、光散乱法で測定されるストーク ス径を指すものである。また平均粒径は、メディアン径を指すものである。また、その形 状は特に制限は無く、球状、不定形いずれでも良く、一液性エポキシ樹脂組成物の低粘度 化のためには、球状が好ましい。ここで球状とは、真球は勿論の事、不定形の角が丸みを 帯びた形状をも包含する。

本発明の潜在性硬化剤は、本発明のアミン系硬化剤をイソシアネート(D)と活性水素 出証特2005-3042289 化合物(E)の反応により得られた皮膜で被覆することで得られる。

[0026]

イソシアネート (D) としては、1分子中に1個以上のイソシアネート基を有する化合 物であればよいが、好ましくは1分子中に2個以上のイソシアネート基を有する化合物を 用いることであり、好ましいイソシアネートとしては、脂肪族ジイソシアネート、脂環式 ジイソシアネート、芳香族ジイソシアネート、低分子トリイソシアネート、ポリイソシア ネートを挙げることができる。脂肪族ジイソシアネートの例としては、エチレンジイソシ アネート、プロピレンジイソシアネート、ブチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジ イソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等を挙げることができる。 脂環式ジイソシアネートの例としては、イソホロンジイソシアネート、4-4'-ジシク ロヘキシルメタンジイソシアネート、ノルボルナンジイソシアネート、1,4ーイソシア ナトシクロヘキサン、1,3-ビス(イソシアナトメチル)-シクロヘキサン、1,3-ビス (2-イソシアナトプロピルー2イル) -シクロヘキサン等を挙げることができる。 芳香族ジイソシアネートの例としては、トリレンジイソシアネート、4,4'ージフェニ ルメタンジイソシアネート、キシレンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシア ネート等を挙げることができる。低分子トリイソシアネートの例としては、1,6,11 ーウンデカントリイソシアネート、1,8-ジイソシアネートー4-イソシアネートメチ ルオクタン、1,3,6-ヘキサメチレントリイソシアネート、2,6-ジイソシアナト ヘキサン酸-2-イソシアナトエチル、2,6-ジイソシアナトヘキサン酸-1-メチル - 2 - イソシアネートエチル等の脂肪族トリイソシアネート化合物、トリシクロヘキシル メタントリイソシアネート、ビシクロヘプタントリイソシアネート等の脂環式トリイソシ アネート化合物、トリフェニルメタントリイソシアネート、トリス(イソシアネートフェ ニル)チオホスフェート等の芳香族トリイソシアネート化合物等を挙げることができる。 ポリイソシアネートとしては、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネートや上記ジイ ソシアネート、低分子トリイソシアネートより誘導されるポリイソシアネートが例示され る。上記ジイソシアネート、トリイソシアネートより誘導されるポリイソシアネートとし ては、イソシアヌレート型ポリイソシアネート、ビュレット型ポリイソシアネート、ウレ タン型ポリイソシアネート、アロハネート型ポリイソシアネート、カルボジイミド型ポリ イソシアネート等がある。

[0027]

これらイソシアネート(D)は併用して用いることができる。

イソシアネート(D)としては、脂肪族トリイソシアネート化合物が好ましく、1,8 ージイソシアネートー4ーイソシアネートメチルオクタン、2,6ージイソシアナトヘキ サン酸-2-イソシアナトエチルが更に好ましい。

本発明に用いられる活性水素化合物 (E) としては、水、1分子中に1個以上の一級お よび/または二級アミノ基を有する化合物、1分子中に1個以上の水酸基を有する化合物 が例示される。これらは併用する事もできる。水、1分子中に1個以上の水酸基を有する 化合物が好ましい。

[0028]

活性水素化合物(E)として用いられる1分子中に1個以上の一級および/または二級 アミノ基を有する化合物としては、脂肪族アミン、脂環式アミン、芳香族アミンを使用す ることができる。脂肪族アミンの例としては、メチルアミン、エチルアミン、プロピルア ミン、ブチルアミン、ジブチルアミン等のアルキルアミン。エチレンジアミン、プロピレ ンジアミン、ブチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン等のアルキレンジアミン。ジエ チレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン等のポリアルキ レンポリアミン、ポリオキシプロピレンジアミン、ポリオキシエチレンジアミン等のポリ オキシアルキレンポリアミン類等を挙げることができる。脂環式アミンの例としては、シ クロプロピルアミン、シクロブチルアミン、シクロペンチルアミン、シクロヘキシルアミ ン、イソホロンジアミン等を挙げることができる。芳香族アミンとしては、アニリン、ト ルイジン、ベンジルアミン、ナフチルアミン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフ ェニルスルホン等を挙げることができる。

[0029]

活性水素化合物(E)として用いられる1分子中に1個以上の水酸基を有する化合物と しては、アルコール化合物とフェノール化合物が例示される。アルコール化合物としては 、メチルアルコール、プロピルアルコール、ブチルアルコール、アミルアルコール、ヘキ シルアルコール、ヘプチルアルコール、オクチルアルコール、ノニルアルコール、デシル アルコール、ウンデシルアルコール、ラウリルアルコール、ドテシルアルコール、ステア リルアルコール、エイコシルアルコール、アリルアルコール、クロチルアルコール、プロ パルギルアルコール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、ベンジルアルコール、 シンナミルアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモ ノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ ブチル等のモノアルコール類、エチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレ ングリコール、ポリプロピレングリコール、1,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジ オール、水添ビスフェノールA、ネオペンチルグリコール、グリセリン、トリメチロール プロパン、ペンタエリスリトール等の多価アルコール類を挙げることができる。また、1 分子中に1個以上のエポキシ基を有する化合物と、1分子中に1個以上の水酸基、カルボ キシル基、一級または二級アミノ基、メルカプト基を有する化合物との反応により得られ る二級水酸基を1分子中に2個以上有する化合物も多価アルコール類として例示される。 これらのアルコール化合物においては、第一、第二、または第三アルコールのいずれでも よい。フェノール化合物としては、石炭酸、クレゾール、キシレノール、カルバクロール 、モチール、ナフトール等のモノフェノール類、カテコール、レゾルシン、ヒドロキノン ビスフェノールA、ビスフェノールF、ピロガロール、フロログルシン等の多価フェノ ール類を挙げることができる。これら1分子中に1個以上の水酸基を有する化合物として は、多価アルコール類や多価フェノール類等が好ましい。多価アルコール類が更に好まし 61

[0030]

イソシアネート (D) と活性水素化合物 (E) の反応は、通常-10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 度範囲で、10分~12時間の反応時間で行われる。必要により分散媒中で行なうことが できる。分散媒としては、溶媒、可塑剤、樹脂類等が例示される。溶媒としては、例えば 、ベンゼン、トルエン、キシレン、シクロヘキサン、ミネラルスピリット、ナフサ等の炭 化水素類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、酢酸 エチル、酢酸-n-ブチル、プロピレングリコールモノメチルエチルエーテルアセテート 等のエステル類、メタノール、イソプロパノール、n-ブタノール、ブチルセロソルブ、 ブチルカルビトール等のアルコール類、水、等が例示される。可塑剤としては、フタル酸 ジブチル、フタル酸ジ(2-エチルヘキシシル)等のフタル酸ジエステル系、アジピン酸 ジ (2-エチルヘキシシル)等の脂肪族二塩基酸エステル系、リン酸トリクレジル等のリ ン酸トリエステル系、ポリエチレングリコールエステル等のグリコールエステル系等が例 示される。樹脂類としては、シリコーン樹脂類、エポキシ樹脂類、フェノール樹脂類等が 例示される。

[0031]

イソシアネート(D)と活性水素化合物(E)との量比は、特に制限は無いが通常、イ ソシアネート(D)中のイソシアネート基と活性水素化合物(E)中の活性水素との当量 比が1:0.1~1:1000の範囲で用いられる。

イソシアネート成分(D)と活性水素化合物(E)との反応物で、本発明のアミン系硬 化剤を被服する方法としては、得られた反応物を溶解し、本発明のアミン系硬化剤を分散 させた液体中で反応物の溶解度を下げて、本発明のアミン系硬化剤の表面に析出させる方 法、本発明のアミン系硬化剤が分散媒中に分散した状態での存在下に、イソシアネート(D) と活性水素化合物 (E) とを反応させて、反応物を本発明のアミン系硬化剤の表面に 析出させる、あるいは本発明のアミン系硬化剤の表面を反応の場とし、そこで反応物を生 成させる方法等が挙げられる。後者の方法が反応と被服を同時に行なうことができ好まし 130

$[0\ 0\ 3\ 2\]$

得られた皮膜は、波数1630cm⁻¹~1680cm⁻¹の赤外線を吸収する結合基(x)を有することが好ましい。結合基(x)としては、ウレア結合が特に好ましい。更に、 得られた皮膜は、 $1680\sim1725$ cm-1の赤外線を吸収する結合基(y)、および /または、波数が1730~1755cm-1の赤外線を吸収する結合基(z)を有する ことが好ましい。結合基(y)としてはビュレット結合が、結合基(z)としてはウレタ ン結合が特に好ましい。

このウレア結合、ビュレット結合はイソシアネート (D) と水および/または1分子中 に1個以上の一級および/または二級アミノ基を有するアミン化合物との反応により生成 される。また、ウレタン結合は、イソシアネート(D)と1分子中に1個以上の水酸基を 有する化合物との反応により生成される。

結合基(x)、結合基(y)と結合基(z)は、フーリエ変換式赤外分光光度計(FT - I Rと称す)を用いて測定することができる。

本発明の潜在性硬化剤は、次に説明するコアシェル型硬化剤にすることで、更に高い貯 蔵安定性が得られ、好ましい。

本発明のコアシェル型硬化剤は、本発明のアミン系硬化剤および/または本発明の潜在 性硬化剤をコアとし、本発明のアミン系硬化剤とエポキシ樹脂(F)の反応生成物をシェ ルとした硬化剤である。

[0033]

本発明に用いられるエポキシ樹脂(F)としては、例えば、ビスフェノールA、ビスフ エノールF、ビスフェノールAD、ビスフェノールS、テトラメチルビスフェノールA、 テトラメチルビスフェノールF、テトラメチルビスフェノールAD、テトラメチルビスフ ェノールS、テトラブロモビスフェノールA、テトラクロロビスフェノールA、テトラフ ルオロビスフェノールA等のビスフェノール類をグリシジル化したビスフェノール型エポ キシ樹脂;ビフェノール、ジヒドロキシナフタレン、9,9ービス(4ーヒドロキシフェ ニル)フルオレン等のその他の2価フェノール類をグリシジル化したエポキシ樹脂;1, 1, 1-トリス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、4, 4- (1-(4-(1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル)フェニル)エチリデン) ビスフェノール等の トリスフェノール類をグリシジル化したエポキシ樹脂;1,1,2,2,ーテトラキス(4-ヒドロキシフェニル)エタン等のテトラキスフェノール類をグリシジル化したエポキ シ樹脂;フェノールノボラック、クレゾールノボラック、ビスフェノールAノボラック、 臭素化フェノールノボラック、臭素化ビスフェノールAノボラック等のノボラック類をグ リシジル化したノボラック型エポキシ樹脂等;多価フェノール類をグリシジル化したエポ キシ樹脂、グリセリンやポリエチレングリコール等の多価アルコールをグリシジル化した 脂肪族エーテル型エポキシ樹脂;pーオキシ安息香酸、βーオキシナフトエ酸等のヒドロ キシカルボン酸をグリシジル化したエーテルエステル型エポキシ樹脂;フタル酸、テレフ タル酸のようなポリカルボン酸をグリシジル化したエステル型エポキシ樹脂; 4, 4-ジ アミノジフェニルメタンやm-アミノフェノール等のアミン化合物のグリシジル化物やト リグリシジルイソシアヌレート等のアミン型エポキシ樹脂等のグリシジル型エポキシ樹脂 と、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル-3',4'-エポキシシクロヘキサンカル ボキシレート等の脂環族エポキサイド等が例示される。

[0034]

エポキシ樹脂(F)としては、得られる硬化物の接着性や耐熱性が優れるため、グリシ ジル型エポキシ樹脂が好ましく、より好ましくは、硬化物の接着性や耐熱性が優れるため 多価フェノール類をグリシジル化したエポキシ樹脂であり、更に好ましくはビスフェノー ル型エポキシ樹脂である。ビスフェノールAをグリシジル化したエポキシ樹脂とビスフェ ノールFをグリシジル化したエポキシ樹脂が一層好ましい。ビスフェノールAをグリシジ ル化したエポキシ樹脂が更に一層好ましい。

エポキシ樹脂(F)の全塩素量は、硬化性と貯蔵安定性のバランスの取れた一液性エポ

キシ樹脂組成物を得るためには、1500ppm以下が好ましい。

より好ましくは1000ppm以下であり、より好ましくは800ppm以下であり、 より好ましくは400ppm以下であり、より好ましくは180ppm以下であり、より 好ましくは171ppm以下であり、より好ましくは100ppm以下であり、より好ま しくは80ppm以下であり、さらに好ましくは50ppm以下である。

[0035]

本発明のアミン系硬化剤とエポキシ樹脂(F)との反応は、通常-10 $^{\circ}$ \sim 150 $^{\circ}$ 、 好ましくは0℃~100℃の温度範囲で、1~168時間、好ましくは2時間~72時間 の反応時間で行われ、分散媒中で行なうこともできる。分散媒としては、溶媒、可塑剤等 が例示される。

溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、シクロヘキサン、ミネラルス ピリット、ナフサ等の炭化水素類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケ トン等のケトン類、酢酸エチル、酢酸-n-ブチル、プロピレングリコールモノメチルエ チルエーテルアセテート等のエステル類、メタノール、イソプロパノール、nーブタノー ル、ブチルセロソルブ、ブチルカルビトール等のアルコール類、水、等が例示される。可 塑剤としては、フタル酸ジブチル、フタル酸ジ(2-エチルヘキシシル)等のフタル酸ジ エステル系、アジピン酸ジ (2-エチルヘキシシル)等の脂肪族二塩基酸エステル系、リ ン酸トリクレジル等のリン酸トリエステル系、ポリエチレングリコールエステル等のグリ コールエステル系等が例示される。

[0036]

本発明のアミン系硬化剤とエポキシ樹脂(F)とを反応させる時の量比は、特に制限は 無いが通常、質量比で1:0.001~1:1000の範囲、好ましくは1:0.01~ 1:100の範囲で用いられる。

本発明のアミン系硬化剤とエポキシ樹脂(F)との反応生成物からなるシェル(以下、 本シェルと称す)で、本発明のアミン系硬化剤および/または本発明の潜在性硬化剤から なるコア(以下、本コアと称す)を被服する方法としては、本シェルを溶解し、本コアを 分散させた分散媒中で本シェルの溶解度を下げて、本コアの表面に析出させる方法、本コ アをエポキシ樹脂(F)および/またはエポキシ樹脂(F)が溶解した分散媒に分散した 後、本発明のアミン系硬化剤とエポキシ樹脂(F)とを反応させて、本シェルを本コアの 表面に析出させる、あるいは本コアの表面を反応の場として、そこで本シェルを生成させ る方法等が挙げられる。後者の方法が反応と被服を同時に行なうことができ好ましい。

[0037]

また、後者の場合、本発明のアミン系硬化剤は、本コア中のアミン系硬化剤を使用して も構わないし、別途添加しても構わない。

本コアの表面を覆う本シェルの厚みは、平均層厚で5~1000nmが好ましい。5n m以上で貯蔵安定性が得られ、1000nm以下で、実用的な硬化性が得られる。ここで いう層の厚みは、透過型電子顕微鏡により観察される。特に好ましいシェルの厚みは、平 均層厚で50~700nmである。

本発明のアミン系硬化剤、潜在性硬化剤、コアシェル型硬化剤よりなる群より選ばれる 少なくとも1種の硬化剤を次に説明するマスターバッチ型硬化剤にすることで、一液性エ ポキシ樹脂組成物を得る時に、エポキシ樹脂との混合が容易になり好ましい。

[0038]

本発明のエポキシ樹脂用マスターバッチ型硬化剤は、本発明のアミン系硬化剤、潜在性 硬化剤、コアシェル型硬化剤よりなる群より選ばれる少なくとも1種の硬化剤100質量 部に対して、10~50,000質量部(好ましくは20~20,000質量部)のエポ キシ樹脂(F)より構成される。エポキシ樹脂(F)が10質量部以上で取り扱いが容易 なエポキシ樹脂用マスターバッチ型硬化剤が得られ、50,000質量部以下で実質的に 硬化剤としての性能を発揮する。

本発明のエポキシ樹脂用マスターバッチ型硬化剤を製造する方法として、先に製造され た本発明のアミン系硬化剤、潜在性硬化剤、コアシェル型硬化剤よりなる群より選ばれる

少なくとも1種の硬化剤を、例えば、三本ロール等を用いてエポキシ樹脂(F)中に分散 させる方法や、エポキシ樹脂(F)の中で潜在性硬化剤および/またはコアシェル型硬化 剤の生成反応を行い、潜在性硬化剤および/またはコアシェル型硬化剤を得ると同時に、 エポキシ樹脂用マスターバッチ型硬化剤を得る方法等が例示される。後者が、生産性が高 く好ましい。

[0039]

本発明のエポキシ樹脂用マスターバッチ型硬化剤は室温で液状又はペースト状が好まし い。より好ましくは、25℃での粘度が50万mPa·s以下、更に好ましくは、100 0~30万mPa·s、一層好ましくは3000~20万mPa·sである。

粘度が50万mPa・s以下で作業性が高く、容器への付着量を下げて廃棄物の低減が 可能であり好ましい。

本発明のエポキシ樹脂用マスターバッチ型硬化剤は、本発明の潜在性硬化剤および/ま たはコアシェル型硬化剤とエポキシ樹脂(F)より構成されるが、その機能を低下させな い範囲で、その他の成分を含有することができる。その他の成分の含有量は、好ましくは 30質量%未満である。

エポキシ樹脂(G)に、本発明のアミン系硬化剤、潜在性硬化剤、コアシェル型硬化剤 よりなる群より選ばれる少なくとも1種の硬化剤(以下本硬化剤と称す)を混合して本発 明の一液性エポキシ樹脂組成物が得られる。

[0040]

本発明のエポキシ樹脂組成物に用いられるエポキシ樹脂 (G) は、平均して1分子当た り2個以上のエポキシ基を有するものであればよく、例えば、ビスフェノールA、ビスフ ェノールF、ビスフェノールAD、ビスフェノールS、テトラメチルビスフェノールA、 テトラメチルビスフェノールF、テトラメチルビスフェノールAD、テトラメチルビスフ エノールS、テトラブロモビスフェノールA、テトラクロロビスフェノールA、テトラフ ルオロビスフェノールA等のビスフェノール類をグリシジル化したビスフェノール型エポ キシ樹脂;ビフェノール、ジヒドロキシナフタレン、9,9ービス(4ーヒドロキシフェ ニル)フルオレン等のその他の2価フェノール類をグリシジル化したエポキシ樹脂;1, 1, 1-トリス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、4, 4- (1- (4- (1- (4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル)フェニル)エチリデン)ビスフェノール等の トリスフェノール類をグリシジル化したエポキシ樹脂;1,1,2,2,一テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)エタン等のテトラキスフェノール類をグリシジル化したエポキ シ樹脂;フェノールノボラック、クレゾールノボラック、ビスフェノールAノボラック、 臭素化フェノールノボラック、臭素化ビスフェノールAノボラック等のノボラック類をグ リシジル化したノボラック型エポキシ樹脂等;多価フェノール類をグリシジル化したエポ キシ樹脂;グリセリンやポリエチレングリコールのような多価アルコールをグリシジル化 した脂肪族エーテル型エポキシ樹脂;p-オキシ安息香酸、 $\beta-$ オキシナフトエ酸のよう なヒドロキシカルボン酸をグリシジル化したエーテルエステル型エポキシ樹脂;フタル酸 、テレフタル酸のようなポリカルボン酸をグリシジル化したエステル型エポキシ樹脂;4 4 -ジアミノジフェニルメタンやm-アミノフェノール等のアミン化合物のグリシジル 化物やトリグリシジルイソシアヌレート等のアミン型エポキシ樹脂と、3,4-エポキシ シクロヘキシルメチルー3',4'ーエポキシシクロヘキサンカルボキシレート等の脂環 族エポキサイド等が例示される。

[0041]

また、本発明に用いられるエポキシ樹脂(G)は、エポキシ樹脂の高分子量体で、自己 成膜性を有する一般にフェノキシ樹脂と呼ばれる樹脂をも包含される。 エポキシ樹脂(G) の全塩素量は、硬化性と貯蔵安定性のバランスの取れた一液性エポキシ樹脂組成物を 得るためには、1500ppm以下が好ましい。

より好ましくは1000ppm以下であり、より好ましくは800ppm以下であり、よ り好ましくは400ppm以下であり、より好ましくは180ppm以下であり、より好 ましくは171ppm以下であり、より好ましくは100ppm以下であり、より好まし くは80ppm以下であり、さらに好ましくは50ppm以下である。

本硬化剤とエポキシ樹脂(G)の混合比は、硬化性、硬化物の特性の面から決定される ものであるが、好ましくはエポキシ樹脂(G)100質量部に対して、本硬化剤中に含ま れるアミン系硬化剤量が $0.1\sim100$ 質量部となる量で用いればよい。より好ましくは 、0.2~80質量部、更に好ましくは、0.5~60質量部である。0.1質量部以上 で実用的に満足し得る硬化性能を得ることができ、100質量部以下で、アミン系硬化剤 が偏在することなく、バランスの良い硬化性能を有する硬化剤を与える。

[0042]

本発明の一液性エポキシ樹脂組成物は、本硬化剤以外に硬化剤(H)を併用することが できる。

硬化剤(H)は、酸無水物類、フェノール類、ヒドラジド類およびグアニジン類より成 る群より選ばれる。複数を併用することもできる。

酸無水物類としては、例えば、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット 酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、無水テトラヒドロフタル酸、無水ー3ークロロフタル酸 、無水ー4ークロロフタル酸、無水ベンゾフェノンテトラカルボン酸、無水コハク酸、無 水メチルコハク酸、無水ジメチルコハク酸、無水ジクロールコハク酸、メチルナジック酸 、ドテシルコハク酸、無水クロレンデックク酸、無水マレイン酸等;フェノール類として は、例えば、フェノールノボラック、クレゾールノボラック、ビスフェノールAノボラッ ク等;ヒドラジン類としては、例えば、コハク酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド 、フタル酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジドテレフタル酸ジヒドラジド、p-オ キシ安息香酸ヒドラジド、サリチル酸ヒドラジド、フェニルアミノプロピオン酸ヒドラジ ド、マレイン酸ジヒドラジド等;グアニジン類としては、例えば、ジシアンジアミド、メ チルグアニジン、エチルグアニジン、プロピルグアニジン、ブチルグアニジン、ジメチル グアニジン、トリメチルグアニジン、フェニルグアニジン、ジフェニルグアニジン、トル イルグアニジン等が例示される。

[0043]

硬化剤(H)として好ましいのは、グアニジン類および酸無水物類である。さらに好ま しくは、ジシアンジアミド、無水ヘキサヒドロフタル酸、無水メチルテトラヒドロフタル 酸、無水メチルナジック酸である。

硬化剤(H)を使用する場合、エポキシ樹脂(G)100質量部に対して、硬化剤(H)を1~200質量部、本硬化剤をアミン系硬化剤の全量が0.1~100質量部となる 量で用いるのが好ましい。

この範囲で用いることで硬化性と貯蔵安定性に優れた組成物を与え、耐熱性、耐水性に 優れた硬化物を得ることができる。

本硬化剤を用いて一液性エポキシ樹脂組成物を製造する場合には、所望によって、増量 剤、補強材、充填材、導電微粒子、顔料、有機溶剤、反応性希釈剤、非反応性希釈剤、樹 脂類、カップリング剤等を添加することができる。充填剤の例としては、例えば、コール タール、ガラス繊維、アスベスト繊維、ほう素繊維、炭素繊維、セルロース、ポリエチレ ン粉、ポリプロピレン粉、石英紛、鉱物性ケイ酸塩、雲母、アスベスト粉、スレート粉、 カオリン、酸化アルミニウム三水和物、水酸化アルミニウム、チョーク粉、石こう、炭酸 カルシウム、三酸化アンチモン、ペントン、シリカ、エアロゾル、リトポン、バライト、 二酸化チタン、カーボンブラック、グラファイト、酸化鉄、金、アルミニウム粉、鉄粉等 を挙げることができ、これらはいずれもその用途に応じて有効に用いられる。有機溶剤と しては、例えば、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、 酢酸エチル、酢酸ブチル等が挙げられる。反応性希釈剤としては、例えば、ブチルグリシ ジルエーテル、N, N' ーグリシジルーoートルイジン、フェニルグリシジルエーテル、 スチレンオキサイド、エチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコール ジグリシジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル等が挙げられる 。非反応性希釈剤としては、例えば、ジオクチルフタレート、ジブチルフタレート、ジオ クチルアジベート、石油系溶剤等が挙げられる。樹脂類としては、例えば、ポリエステル 樹脂、ポリウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリエーテル樹脂、メラミン樹脂やウレタン変 性エポキシ樹脂、ゴム変性エポキシ樹脂、アルキッド変性エポキシ樹脂等の変性エポキシ 樹脂が挙げられる。

[0044]

本発明の一液性エポキシ樹脂組成物は、本硬化剤とエポキシ樹脂(G)および必要に応 じ硬化剤(H)が主成分である。本発明の一液性エポキシ樹脂組成物は加熱により硬化す ることで所望の性能が発現されるが、ここで言う主成分とは、加熱による硬化反応の主体 をなす成分であることを意味し、加熱硬化性成分の60%以上である事が好ましい。更に 好ましくは70%以上である。

一液性エポキシ樹脂組成物の内、硬化に関与しない成分としては、例えば、増量剤、補 強材、充填材、導電粒子、顔料、有機溶剤、樹脂類等が挙げられるが、これらの成分は一 液性エポキシ樹脂組成物全体に対して0~90質量%の範囲で使用されるのが好ましい。

[0045]

本発明の一液性エポキシ樹脂組成物は、接着剤、封止材、充填材料、絶縁材料、導電材 料、異方導電材料、シール材料、プリプレグ等として有用である。接着剤としては、液状 接着剤やフィルム状接着剤、ダイボンディング材等として有用である。封止材としては、 固形封止材や液状封止材、フィルム状封止材等として有用であり、液状封止材としては、 アンダーフィル材、ポッティング材、ダム材等として有用である。絶縁材料としては、絶 縁接着フィルム、絶縁接着ペースト、ソルダーレジスト等として、導電材料としては導電 フィルム、導電ペースト等として、異方導電材料としては、異方導電性フィルム、異方導 電性ペースト等として有用である。

[0046]

導電材料や異方導電材料として用いる場合は、本発明の一液性エポキシ樹脂組成物に導 電粒子を分散させて用いられる。導電粒子としては半田粒子、ニッケル粒子、金属の表面 を他の金属で被覆した粒子、銅と銀の傾斜粒子等の金属粒子や、例えば、スチレン樹脂、 ウレタン樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、スチレン ーブタジエン樹脂等の樹脂粒子に金、ニッケル、銀、銅、半田などの導電性薄膜で被覆を 施した粒子等が使用される。一般に導電粒子は1~20μm程度の球形の微粒子である。 フィルムにする場合は、一液性エポキシ樹脂組成物に溶剤を配合し、例えば、ポリエステ ル、ポリエチレン、ポリイミド、ポリテトラフルオロエチレン等の基材に塗布後溶剤を乾 燥させる方法等がある。

絶縁材料や封止材として用いる場合は、本発明の組成物に、シリカ等のフィラーを充填 剤として添加する。フィルムにする場合は、一液性エポキシ樹脂組成物に溶剤を配合し、 ポリエステル等の基材に塗布後溶剤を乾燥させる方法等がある。

【実施例】

[0047]

本発明を実施例に基づき、更に詳しく説明するが本発明の技術範囲およびその実施態様 はこれらに限定されるものではない。実施例及び比較例中の「部」または「%」は特記し ない限り質量基準である。

以下に述べる手法により、本実施例および比較例に係る樹脂およびその硬化物の物性評 価試験を行った。

(1) エポキシ当量

1 当量のエポキシ基を含むエポキシ樹脂の質量(g)であり、JIS K-7236に 進拠して求めた。

(2) 全塩素量

試料1gを25m1のエチレングリコールモノブチルエーテルに溶解し、これに1規定 KOHのプロピレングリコール溶液25mlを加えて20分間煮沸したのち、硝酸銀水溶 液で滴定した。

[0048]

(3) 加水分解性塩素量

試料3gを50m1のトルエンに溶解し、これに0.1規定КОНのメタノール溶液2 0m1を加えて15分間煮沸した後、硝酸銀水溶液で滴定した。

- (4) 粘度
- 25℃でBM型粘度計を使用して測定した。
- (5) 軟化点
 - JⅠS K-7234 (環球法) に準拠した。
- (6) FT-IR測定

日本分光(株)社製FT/IR-410を使用し吸光度を測定した。

[0049]

(7) 分子量分布

東ソー (株) 製HLC8220GPC (検出器:RI) を用い、カラム:PLge13 μΜΙΧΕD-Ε (ポリマーラボラトリー社製) 2本、溶離液:ジメチルホルムアミド1 %リチウムブロマイド溶液、検量線:ポリスチレンの条件でゲルパーミッションクロマト グラフィを行ない、重量平均分子量を数平均分子量で割った値で分子量分布を示した。

(8) マスターバッチ型硬化剤からのコアシェル型硬化剤の分離

マスターバッチ型硬化剤を、キシレンを用いて、エポキシ樹脂が無くなるまで洗浄と濾 過を繰り返す。次に、キシレンが無くなるまでシクロヘキサンで洗浄と濾過を繰り返す。 シクロヘキサンを濾別し、50℃以下の温度でシクロヘキサンを完全に除去乾燥する。

(9) ゲルタイム測定

(株) テイ・エスエンジニアリング社製のキュラストメーターV型を使用し、JIS K6300に準拠して求めた。

[0050]

(10) 一液性エポキシ樹脂組成物の貯蔵安定性

実施例または比較例で製造したマスターバッチ型硬化剤30部をビスフェノールA型エ ポキシ樹脂(エポキシ当量189g/当量、全塩素量1200ppm:以下エポキシ樹脂 c-3と称す)100部と混合、一液性エポキシ樹脂を製造し、40℃で1週間貯蔵し、 貯蔵後の粘度を貯蔵前粘度割った値(以下粘度倍率と称す)により貯蔵安定性を評価した 。粘度倍率が2倍未満を○、2倍以上3倍未満を△、3倍以上を×、貯蔵途中でゲル化し たものを××とした。

(11) 一液性エポキシ樹脂組成物の硬化性

実施例または比較例で製造したマスターバッチ型硬化剤30部をエポキシ樹脂c-3の 100部と混合、一液性エポキシ樹脂を製造、100℃でゲルタイムを測定し、一液性エ ポキシ樹脂組成物の硬化性の指標にした。

[0051]

「製造例1]

(アミンアダクト(A)の製造)

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エポキシ当量175g/当量、全塩素量1600p pm:以下エポキシ樹脂 c-1と称す) 1当量と、2-メチルイミダゾール1当量(活性 水素換算)を、n-ブタノールとトルエンの1/1混合溶媒中(樹脂分50%)80℃で 6時間反応させた。その後、減圧下200℃で未反応の2-メチルイミダゾールが10p pm未満になるまで蒸留を行ない、溶剤と共に留去し、アミンアダクトa-1を得た。得 られたアミンアダクトの分子量分布は1.4であった。

「製造例2]

(アミンアダクト(A)の製造)

2-メチルイミダゾールの仕込み量を2当量にした以外は製造例1と同様にしてアミン アダクトの製造を行ない、アミンアダクトa-2を得た。得られたアミンアダクトの分子 量分布は1.1であった。

[0052]

「製造例3]

(アミンアダクト (A) の製造)

2-メチルイミダゾールの仕込み量を0.85当量にした以外は製造例1と同様にして アミンアダクトの製造を行ない、アミンアダクトa-3を得た。得られたアミンアダクト の分子量分布は2.1であった。

「製造例4]

(アミンアダクト(A)の製造)

2-メチルイミダゾールの仕込み量を0.7当量にした以外は製造例1と同様にしてア ミンアダクトの製造を行ない、アミンアダクトa-5を得た。得られたアミンアダクトの 分子量分布は3.7であった。

[0053]

「実施例1]

製造例1で得たアミンアダクトa-1の100質量部を溶融し、これに0.8質量部の 2-エチルー4-メチルイミダゾールを均一に混合し、室温に冷却後粉砕して、軟化点が 97℃、平均粒径2.5μmのアミン系硬化剤A-1を得た。 200質量部のエポキシ 樹脂 c-1 に、アミン系硬化剤 A-1 を 1 0 0 質量部、水 1 . 5 質量部、トリレンジイソ シアネート5質量部を加えて、40℃で攪拌しながら3時間反応を続けた。その後、シェ ル形成反応を50℃で8時間行ない、マスターバッチ型硬化剤K-1を得た。

マスターバッチ型硬化剤K-1からキシレンを用いてコアシェル型硬化剤を分離し、F T-IR測定により、結合基(x)、(y)、(z) を有することが確認された。

更に、100部のエポキシ樹脂c-3に、得られたマスターバッチ型硬化剤K-1を3 0部配合したときの一液性エポキシ樹脂組成物の硬化性と貯蔵安定性を評価した。得られ た結果を表1に示す。

[0054]

[実施例2、3]

表1で示した配合で、実施例1と同様にしてアミン系硬化剤A-2、A-3を得た。得 られたアミン系硬化剤の特性を表1に示す。

更に、表1の配合で実施例1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤K-2、K-3を得 た。何れも実施例1と同様にして結合基(x)、(y)、(z)を有することを確認し、 実施例1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤K-2、K-3を硬化剤としたときの一液 性エポキシ樹脂組成物の硬化性と貯蔵安定性を評価した。評価結果を表1に示す。

[0055]

「実施例4]

1 当量のビスフェノールF型エポキシ樹脂(エポキシ当量165g/当量、全塩素量3 0 0 ppm :以下エポキシ樹脂 c − 2 と称す)と、2 − メチルイミダゾール1 当量(活性水 素換算)を、n-ブタノールとトルエンの1/1混合溶媒中(樹脂分50%)80℃で6 時間反応させた。その後、減圧下200℃で未反応の2-メチルイミダゾールと溶剤を留 去し、2-メチルイミダゾールが0.05質量%(樹脂分に対して)とになった時点で蒸 留を終了し、分子量分布が1. 4のアミンアダクト (アミンアダクトa-4と称す) と 0 . 05質量%の2-メチルイミダゾールよりなるアミン系硬化剤A-4を得た。それを室 温下で粉砕して、軟化点が101℃、平均粒径2.4μmのアミン系硬化剤A-4を得た

更に、表1の配合で実施例1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤K-4を得た。実施 例 1 と同様にして結合基(x)、(y)、(z)を有することを確認し、実施例 1 と同様 にしてマスターバッチ型硬化剤 K-4を硬化剤としたときの一液性エポキシ樹脂組成物の 硬化性と貯蔵安定性を評価した。評価結果を表1に示す。

[0056]

「比較例1」

表1で示した配合で、実施例1と同様にしてアミン系硬化剤A-5を得た。得られたア ミン系硬化剤の特性を表1に示す。

更に、表1の配合で実施例1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤K-5を得た。実施 例1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤K-5を硬化剤としたときの一液性エポキシ樹 脂組成物の硬化性と貯蔵安定性を評価した。評価結果を表1に示す。

表1に示したようにアミンアダクト (A) の分子量分布が3を越える本比較例では、硬 化温度条件でアミンアダクト(A)のエポキシ樹脂への拡散性が低下するため、硬化性が 低い結果となっている。

[0057]

「比較例 2]

1 当量のエポキシ樹脂 c - 1 と、2 - メチルイミダゾール 0. 8 5 当量(活性水素換算) を、n-ブタノールとトルエンの1/1混合溶媒中(樹脂分50%) 80℃で6時間反 応させた。その時の未反応の2-メチルイミダゾール量は2.0質量%(樹脂分に対して) であった。その後、減圧下180℃で溶剤を留去し、分子量分布が2. 1のアミンアダ クト (アミンアダクトa-6と称す) と2-メチルイミダゾールを2.0質量%含有する アミン系硬化剤を得た。

それを室温下で粉砕して、軟化点が94℃、平均粒径2.5μmのアミン系硬化剤A-6 を得た。

更に、表1の配合で実施例1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤K-6を得た。実施 例1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤K-6を硬化剤としたときの一液性エポキシ樹 脂組成物の硬化性と貯蔵安定性を評価した。評価結果を表1に示す。

表1に示したように低分子アミン化合物 (B) が1質量部を越える本比較例では、低分 子アミン化合物(B)が貯蔵中にエポキシ樹脂と反応し、貯蔵安定性の低い結果となって

[0058]

[比較例3]

表1で示した配合(アミンアダクトa-1のみ)で、実施例1と同様にしてアミン系硬 化剤A-7を得た。得られたアミン系硬化剤の特性を表1に示す。

更に、表1の配合で実施例1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤K-7を得、実施例 1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤 K-7を硬化剤としたときの一液性エポキシ樹脂 組成物の硬化性と貯蔵安定性を評価した。評価結果を表1に示す。

表1に示したように低分子アミン化合物 (B) が0.001質量部未満の本比較例では マスターバッチ型硬化剤を製造する時に緻密なシェルを形成することができず、貯蔵安定 性の低い結果となっている。

[0059]

[比較例4]

1 当量のエポキシ樹脂 c-1 と、 2-メチルイミダゾール 2 当量(活性水素換算)を、 n-ブタノールとトルエンの1/1混合溶媒中(樹脂分50%) 80℃で6時間反応させ た。その後、減圧下180℃で溶剤を留去し、分子量分布が1.1のアミンアダクト(ア ミンアダクトa-7と称す)と2-メチルイミダゾールを20質量%含有するアミン系硬 化剤を得た。

それを冷却下で粉砕して、軟化点が60℃、平均粒径7.1μmのアミン系硬化剤A-7を得た。

更に、表1の配合で実施例1と同様にしてマスターバッチ型硬化剤の製造を試みたが、 途中でゲル化し、マスターバッチ型硬化剤は得られなかった。

[0060]

表

									1
		年格@ 1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例1	比較例 2	比較例3	比較例 4
_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			247	44 000 2	100 th	流 1 100 部	9-7 100 部
	フェンマガカト (4)	3-1100部	9-2 100 部	a-3 100 部	a-4 100 部	di not c-r	aro ton al	מין דמסיון.	
<u> </u>	いところのことに	1 10 1		2. 1	1.4	3.7	2. 1	1.4	Τ. Τ
111	分子重分布	-	7 . 7		1	4 4 4 4 4	9 M 7		2 M Z
· >		2 F. 4 M.Z	TEDA	2 M Z	7 W ?	IEUA	7 W 7	1	っつ対
N	何分子アミン化合物 (B)	0.6	0.2部	0.3 部	0.05 部	0.2 部	2年		O DIO
一個		1 2	1004	1035	101	103%	94C	103C	၁၈ 9
_	以方点	ر م	7 0 0 1						
蔽	11.7 数代的	2.5	2.9	1.9	2.4	$2. \ 0$	2.5	1.9	7. 1
	十つかにま へん					27	44000	神つの・	100年
i	・フェンを確心を	100部	100%	100部	100部	100部	I U U 部	T O O Ells	H O O T
洲				1	**	140 o o	AX 000 0 -	2-1 900 概	6-2 200 部
育- イ	トポイン雑品	c-1 200 部	c-2 200 部	c-2 200 部	c-2 200 部	C-2 Z00 ED	C-Z ZOU HP	C 1 400 H	
<u>六</u> ≱ シ-	لــــٰــ		1	ato c	NA C	籍。	2 報	1.5 等	2 部
	*	1.5票	金元	2.2 印	di H	i i			
			THE C	MR-200	MR-200	MR-200	MR-200	TDI 5 部	TDI 7 第
<u> </u>	F- インシアネート	五0101	OII o E	11部	9部	£±6	S E		
•	144								779-11. 疗型硬
<u> </u>	液性エポキン樹脂組成物性彫	(_	<u> </u>	<	×	×	化剤製造中
	貯蔵安定性	٥ إ	⊲ ∜		114	硬化せず	13分	15分	ゲル化
	硬化件	12.73	17.0	77 AZ		ı	0 0 THE T		
			-141TI	一四八八十四八		14分 本代/といっ	小西水価 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

宏温素重1000pm/ 全塩素量300ppm) /当量、 (エポキシ当量1758/当量、 (エポキシ当量165g/ エポキシ樹脂c-2:ビスフェノールF型エポキシ樹脂 エポキシ樹脂 c-1:ビスフェノールA型エポキシ樹脂

全塩素量 1 2 0 0 ppm) 運 (エポキシ当量1898) エポキシ樹脂c-3:ビスフェノールA型エポキシ樹脂

2MZ: 2ーメチルイミダゾール

TEDA: トリエチレンジアミン

2 E 4 M Z : 2 ーエチルー4ーメチルイミダゾール

TDI:トリレンジイソシアネート

OTI:1, 8ージイソシアネートー4ーイソシアネートメチルオクタン

MR-200:日本ポリウレタン社製ポリメチレンポリフェニレンポリイソシアネート

予め平均粒径 3 μ m に粉砕したジシアンジアミド 8 質量部に、実施例 3 で得られたマス ターバッチ型硬化剤 K-3の3質量部とエポキシ樹脂 c-3の95質量部、EP-402 3 (アデカ (株) 製CTBN変性エポキシ樹脂) 5 質量部、炭酸カルシウム 2 0 質量部を 加えて均一に混合し、一液性エポキシ樹脂組成物を得た。得られた組成物は40℃×1週 間貯蔵後も使用可能であり、140℃で硬化した。

[0062]

「実施例6]

エポキシ樹脂 c - 1 の 1 0 0 質量部に無水メチルヘキサヒドロフタル酸 8 0 質量部、球 状溶融シリカ粉末(平均粒径10 μm) 300質量部を加えて均一に混合し、それに実施 例4で得られたマスターバッチ型硬化剤K-4の6質量部を加え均一に混合し、液状封止 材を得た。

得られた液状封止材を基板とLSIとの間に挟み、100℃で3時間加熱した後更に1 50℃で3時間加熱した結果、液状封止材は硬化し、封止材として有用であった。本組成 物の液状封止材は、絶縁接着ペーストとしても有用であった。

[0063]

[実施例7]

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エポキシ当量2500g/当量)100質量部を酢 酸エチル40質量部に溶解し、それに、実施例3で得られたマスターバッチ型硬化剤K-3050質量部と粒径 5μ mの導電粒子(金メッキを施した架橋ポリスチレン) 8質量部 とを加え均一に混合し、一液性エポキシ樹脂組成物を得た。これをポリエステルフィルム 上に塗布し、60℃で酢酸エチルを乾燥除去し、異方導電性フィルムを得た。

得られた異方導電性フィルムを電極間に挟み、200℃のホットプレート上で30kg / c m² 、 2 0 秒間熱圧着を行った結果、電極間が接合し、導通がとれ、異方導電性材料 として有用であった。

【産業上の利用可能性】

$[0\ 0\ 6\ 4]$

本発明の硬化剤を用いた一液性エポキシ樹脂組成物は、接着剤、封止材、充填材、絶縁 材料、導電材料、異方導電材料、プリプレグ、フィルム状接着剤、異方導電性フィルム、 異方導電性ペースト、絶縁接着フィルム、絶縁接着ペースト、アンダーフィル材、ポッテ ィング材、ダイボンディング材、導電ペースト、ソルダーレジスト等の分野で好適に利用 できる。

【書類名】要約書

【要約】

本発明は、高い硬化性と貯蔵安定性を両立し得る一液性エポキシ樹脂組成物お 【課題】 よびそれを得るための潜在性硬化剤、そして、貯蔵安定性が高く、低温あるいは短時間の 硬化条件であっても、高い接続信頼性、接着強度、高い封止性が得られる異方導電材料、 導電性接着材料、絶縁接着材料、封止材料等を提供することを目的とする。

【解決の手段】 アミンアダクト(A)と低分子アミン化合物(B)を主成分とするアミ ン系硬化剤であって、アミンアダクト(A)の重量平均分子量と数平均分子量の比として 定義される分子量分布が3以下であって、低分子アミン化合物(B)の含有量がアミンダ クト (A) 100質量部に対して0.001質量部~1質量部であることを特徴とするア ミン系硬化剤。

【選択図】 なし

認定 · 付加情報

特許出願の番号

特願2004-102617

受付番号

5 0 4 0 0 5 3 9 6 2 2

書類名

特許願

担当官

第六担当上席

0095

作成日

平成16年 4月 1日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成16年 3月31日

特願2004-102617

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[303046314]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

2003年 8月20日

新規登録

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

旭化成ケミカルズ株式会社